



平成 29 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 イリソ電子工業株式会社
代 表 者 の 代表取締役社長 由木 幾夫
役 職 氏 名
(コード番号:6908)
取 締 役
問 い 合 せ 先 執行役員 大江 憲一
管 理 本 部 長
電 話 番 号 045-478-3111(代表)

中期経営計画策定に関するお知らせ

当社は、中期経営計画(2017～2019年度)を策定いたしましたので、お知らせいたします。

<中期経営計画骨子>

1. 長期ビジョン

当社は、長期目標として売上高 1,000 億円を達成し、コネクタ・ハーネスを含む接続部品業界内（海外含む）でトップテン入りを目指して参ります。長期ビジョン達成に向けた重点施策は以下となります。

- 1) 伸びる市場（車載市場）の攻略
- 2) 第二の柱（産業機器向け）の確立
- 3) 生産力とコスト力の強化

2. 中期経営計画

上記長期ビジョンの下、当社は今回策定した中期経営計画において、以下の重点施策に取り組んで参ります。

1) 売上高 500 億円の達成に向け

- ① 伸びる市場（車載市場）での売上拡大
- ② 既存分野のシェアアップ
- ③ 海外売上高の拡大
- ④ インダストリアル市場での重点分野の攻略
- ⑤ インダストリアル市場での他社との協業による売上拡大

2) 売上高 1,000 億円を見据え

- ① 技術開発、新製品開発、要素技術開発による Only One 製品の創出
- ② 非日系顧客比率の向上
- ③ 生産拠点の新設
- ④ TSCM 改革による基盤整備
- ⑤ 経営基盤の強化

3. 経営目標

	2017年3期 (実績)	2018年3期 (計画)	2019年3期 (目標)	2020年3期 (目標)
売上高	375億円	400億円	443億円	500億円
営業利益	66億円	72億円	84億円	100億円
営業利益率	17.7%	18.0%	19.0%	20.0%
当期純利益	48億円	52億円	62億円	73億円
総資産	523億円	570億円	630億円	700億円
自己資本比率	84.8%	84.7%	85.7%	85.8%
設備投資	54億円	75億円	75億円	75億円
研究開発費	9億円	12億円	13億円	15億円
ROE	11.7%	11.3%	12.0%	12.8%

※為替レート設定はUSD110円、EUR120円、CNY15.8円（2018年3期～2020年3期）

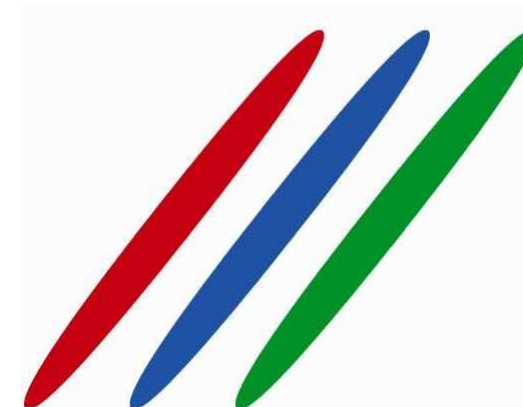
（注）この資料に記載されております業績の予想数値につきましては、本資料の発表日現在で得られた入手可能な資料に基づいて作成したものであり、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

以上



イリソ電子工業株式会社 中期経営計画

2017年5月9日





経営方針

真のグローバル企業を目指し
次のステージへ飛躍

顧客第一
業界No.1

～全社員の知恵をお客様の為に～

経営理念・3G6Sの徹底

13ヶ国のIRISOメンバーが心をひとつに

TEAM IRISOの力を結集

市場の拡大・変化

- 自動車販売台数2020年頃 1億台に(緩やかな伸び)
- 情報化の進展(BIG DATAの活用、IoTの進化)
- 映像技術の進歩(4K・8K高画質など)
- 新興国のインフラ整備加速
- Industry4.0 による生産システムの進化 (含ロボット化)

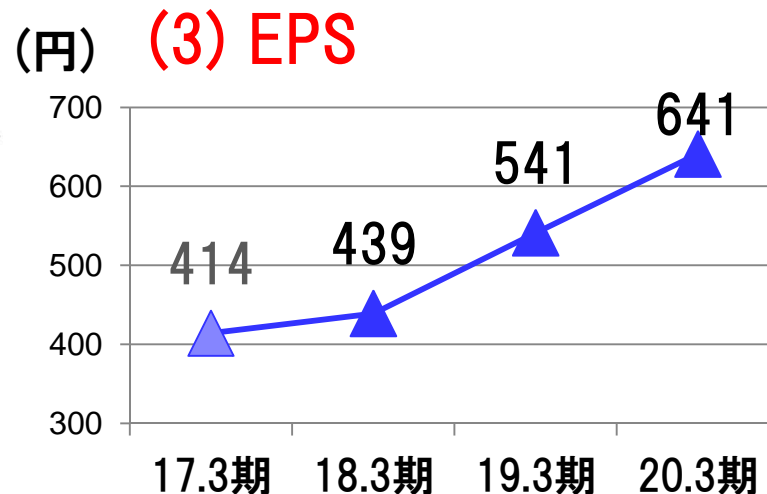
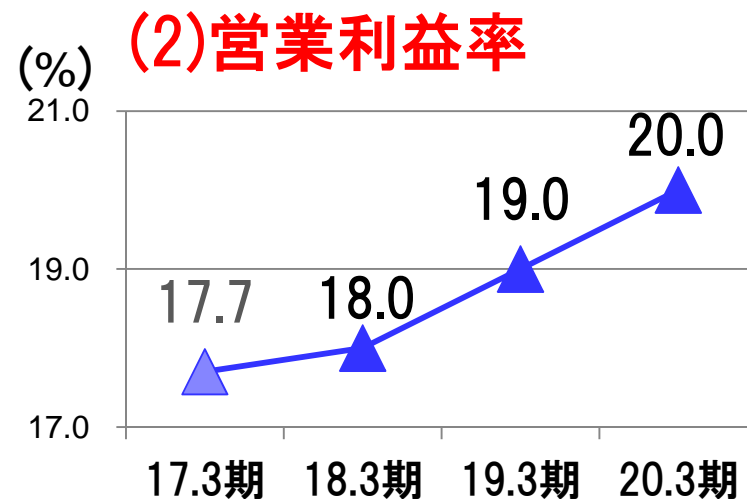
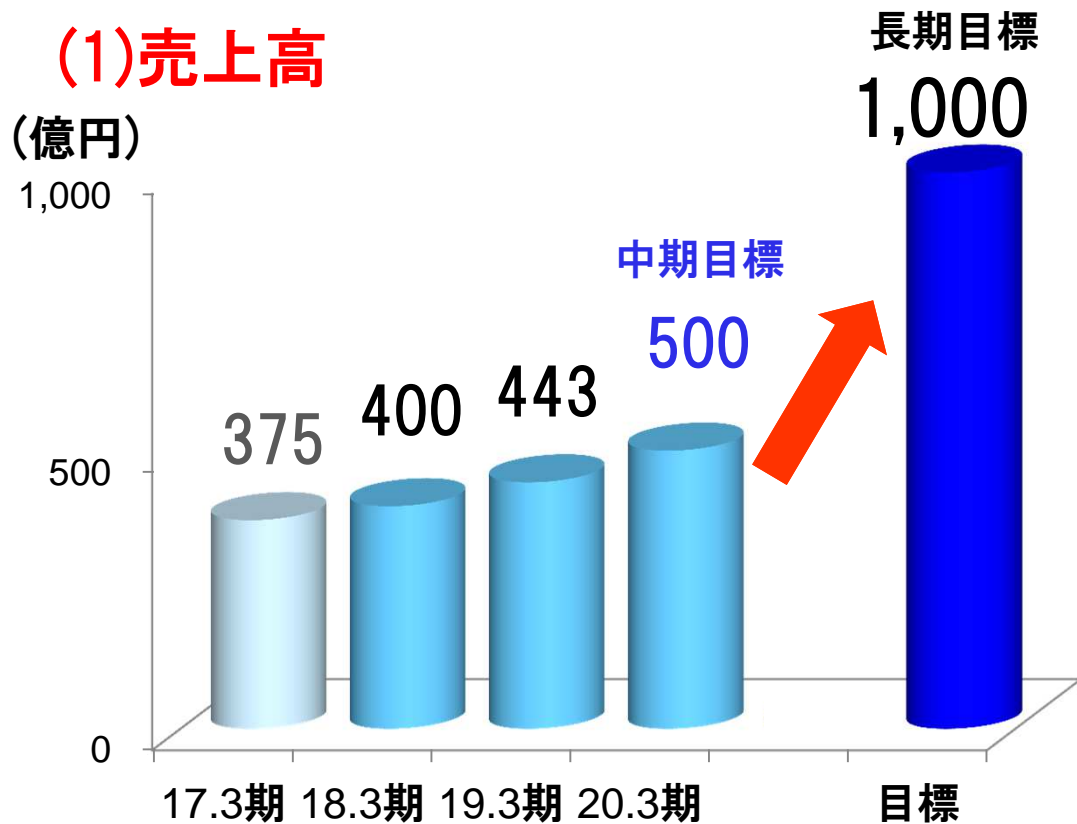
車載市場の拡大

- EV/HEV/PHEV
- Safety(自動ブレーキ、衝突防止)
- Infotainment
(機能集約によるコックピット化)

広がるコネクタの市場

- FA機器(ロボット、AI、PLC)
- 通信機器(通信モジュール等)
- 医療機器(ヘルスケア)
- 事務機器(多機能プリンター、ATM)

ビジョン：売上1,000億円、業界順位世界10位以内



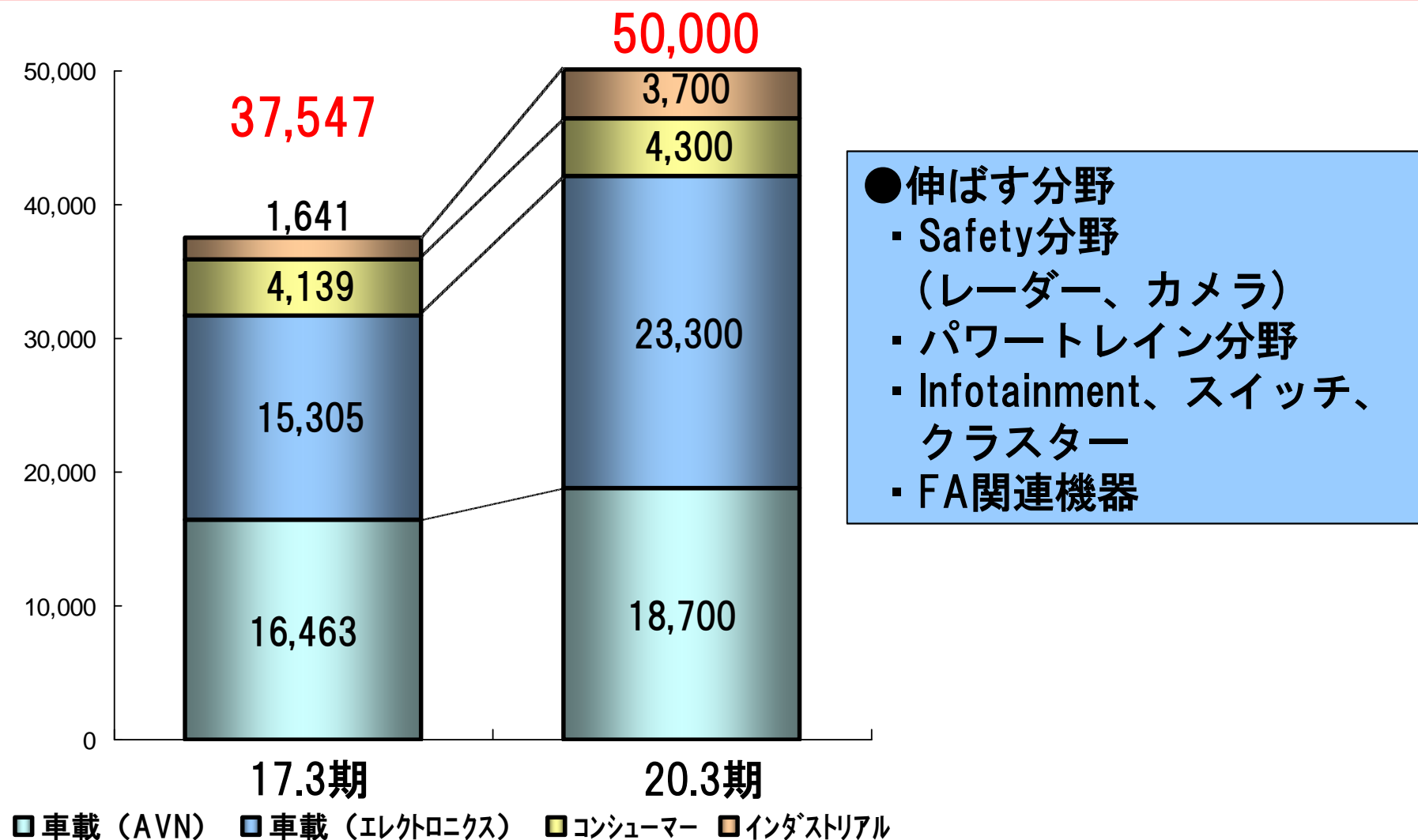
※設定為替レート

	17.3期	18.3-20.3期
USD	109.03	110.00
EUR	119.37	120.00

4. 中期目標(市場別売上高)

単位：百万円

目標：2020年3月 売上500億円





売上1,000億円に向けた基盤整備

重点施策

伸びる市場(車載市場)の攻略

第二の柱(産業機器向け)の確立

生産力とコスト力の強化

売上500億円を達成するための方策①

◆伸びる市場(車載市場)での売上拡大

①ミリ波レーダー、車載カメラを中心に

Safety分野の売上増加

⇒ ・カメラ筐体の拡販

・カメラ内部への世界最小可動BtoBコネクタの拡販

②パワートレイン分野の売上増加

⇒コンバーター、インバーターなどへの

三次元可動BtoBコネクタ“Z-Move™”の拡販

◆既存分野のシェアアップ

①重点顧客の受注獲得

・日系Infotainmentメーカー向けの受注拡大

・クラスター、スイッチ周りの売上拡大(含海外)

売上500億円を達成するための方策②

◆海外売上高の拡大

①欧米での営業力強化

- ・セールスエンジニアの増強
- ・欧州拠点増設及び米国西海岸拠点検討

②中国国内市場でのローカル顧客比率アップ

◆インダストリアル市場での重点分野の攻略

①欧米での間接販売支援の強化

②FA関連機器向けの受注獲得

⇒PLC、サーボ、センサー、インバーターなど

③新興ICT顧客への攻略

◆インダストリアル市場での他社との協業による売上拡大

⇒製品補完による情報通信機器向けの拡大

売上1,000億円を見据えた技術戦略

◆技術開発

市場を先取りした成長分野への
経営資源の集中

◆新製品開発

高信頼性/高機能を備えた製品の
ラインナップ拡充

- ・ Z-Move™の拡充
- ・ 高速伝送/高電流/高電圧対応

◆要素技術開発

将来を見据えた要素技術開発

世界No.1の
Only One
製品の創出

売上1,000億円を達成するための方策

◆伸びる分野へのOnly One製品の開発と拡販

- ①マーケティング強化
- ②車載市場(Safety、パワートレインなど)
- ③非車載市場(ロボット、通信機器分野)

◆海外売上高の拡大

- ①非日系顧客比率50%以上
- ②キーアカウントマネージャー制度の確立

◆第二の柱(産業機器向け)の確立

- ①グローバルビッグ顧客の攻略
- ②協業による顧客提案力の向上
 - ⇒ ・製品補完
 - ・販売チャネルの共有

売上1,000億円に向けた生産拠点の新設

①南通工場

場所	江蘇州南通市
土地面積	約36,000㎡
建屋面積	約26,000㎡予定 (イリソ最大)
販売エリア	中華圏
稼働予定	2017年度中予定
特徴	IoTを駆使した新生産システムの構築。 「スマートファクトリー化」



②メキシコ工場

2017年2月に土地購入完了。ただし、建屋建設は動向注視の上、判断

売上1,000億円に向けたTSCM改革による基盤整備

◆グローバルPSIの構築

⇒IoTを活用したグローバルでの生産管理体制の強化と
設備、金型メンテナンスのシステム化

◆コスト力強化

- ①設計の標準化
- ②素材のグローバル集約購買
- ③海外素材の活用

◆生産技術力強化

- ①設備、金型の標準化
- ②イリソ版Industry4.0の実現

◆生産性向上

⇒IoTを駆使した新生産システムの構築
(スマートファクトリー)

経営基盤の強化

- ◆グローバル人材の育成
 - ・ダイバーシティマネジメント強化
 - ・ワークライフバランスの推進
- ◆コーポレートガバナンスコードの遵守
 - ・社外取締役の複数化
- ◆基本と正道による事業運営

13. 経営目標



	17.3期実績	18.3期 計画	19.3期 目標	20.3期 目標
売上高	375億円	400億円	443億円	500億円
営業利益	66億円	72億円	84億円	100億円
営業利益率	17.7%	18.0%	19.0%	20.0%
当期純利益	48億円	52億円	62億円	73億円
総資産	523億円	570億円	630億円	700億円
自己資本比率	84.8%	84.7%	85.7%	85.8%
設備投資	54億円	75億円	75億円	75億円
研究開発費	9億円	12億円	13億円	15億円
ROE	11.7%	11.3%	12.0%	12.8%
為替前提	ドル109.03円 ユーロ119.37円	ドル110.00円 ユーロ120.00円	ドル110.00円 ユーロ120.00円	ドル110.00円 ユーロ120.00円

◆株主還元について・・・配当性向30%を目指す

会 社 名	イリソ電子工業株式会社
事 業 内 容	各種コネクタの製造・販売
設 立 年 月	1966年（昭和41年）12月
社 員 数	3,489名（平成29年3月31日現在）
資 本 金	5,640百万円（平成29年3月31日現在）
本 社	神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-8
営 業 拠 点	
国 内	本社、岩手県、茨城県、愛知県、大阪府
海 外	シンガポール、香港、アメリカ、ドイツ、タイ、韓国 中国（上海、大連、天津、蘇州）、マレーシア、台湾、 インド
研 究 開 発	本社（イリソテクノロジーパーク）、 川崎（生産技術センター）、上海R&Dセンター
工 場	茨城県、中国（上海市）、フィリピン、ベトナム（ハノイ市）

コネクタの種類

基板対基板コネクタ（BtoBコネクタ）

プリント基板の接続用に開発されたコネクタの総称でボード・ツー・ボードコネクタ（ボードtoボードコネクタ）とも呼ばれる。垂直接続、平行(スタッキング)接続、水平接続など組み合わせで、さまざまな接続が可能となる。B to B（ビー・ツー・ビー）は、当社の登録商標として市場で広く浸透している。

FPC/FFCコネクタ

FPC基板（Flexible printed circuits）やFFCケーブル（Flexible flat cable）の接続用に開発されたコネクタの総称。コネクタの挿入時に力を加えずにロック可能なZIF（Zero insertion Force）タイプ、挿入したときに力が発生するNON-ZIFタイプがある。

I/Fコネクタ

I/Fとは、インターフェイスの略で、機器間の信号の接続を行うコネクタのことで、I/O（インプット／アウトプット）コネクタとも呼ばれる。カーナビ、PCなどさまざまな機器の側面（裏・表面）に装着され、機器への電源供給、音声・映像信号データなどの入出力を行う。

P/H

ピンヘッダーの略。線材をカット加工した“ピン（電導体）”をハウジング（樹脂材でできた絶縁体）で支えたプラグ（オス側）コネクタの基本形であり、さまざまな分野・機器の内部接続（基板間接続）に使用されている。横から見ると、生け花の花止め“けんざん”のように見えるのが特長。メス側はソケットと呼ばれる。

この資料に記載されております業績の予想数値につきましては、本資料の発表日現在で得られた入手可能な資料に基づいて作成したものであり、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみに依拠してご判断されることはお控え下さるようお願いいたします。

なお、本資料の利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。